

05.1;12  
©1995

## О НАРУШЕНИИ КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ МИКРОТВЕРДОСТЬЮ И ПРЕДЕЛОМ ТЕКУЧЕСТИ

*Ю.С.Боярская, Р.П.Житару, М.А.Линте,  
И.Е.Мураховский*

Хорошо известно, что изменение твердости материалов под влиянием каких-либо факторов коррелирует с изменением предела текучести [1–5]. Это мнение настолько общепринято, что даже в энциклопедии приведены сведения о том, что твердость ( $H$ ) меняется в том же направлении, что и предел текучести ( $\sigma_{\text{тек}}$ ) [6]. Для металлов была предложена формула, связывающая эти параметры [1,2]:

$$H = C\sigma_{\text{тек}}, \quad (1)$$

где  $C$  — константа, близкая к трем. Впоследствии подобные соотношения наблюдались и для других материалов [5,7–10].

Однако в настоящей работе на кристаллах  $\text{NaCl}: \text{Mn}$  обнаружено четкое нарушение корреляции между концентрационными зависимостями микротвердости по Виккерсу и пределом текучести (рис. 1)\*. Из рис. 1 следует, что зависимость  $\sigma_{\text{тек}}(c)$  имеет вид кривой с минимумом (кривая 1), а  $H(c)$  — кривой с максимумом (кривая 2). Причем при одной и той же концентрации ( $10^{-2}$  мол.%) наблюдается минимум предела текучести и максимум микротвердости (кривые 1, 2, рис. 1). Вследствие такого несогласованного изменения исследуемых параметров зависимость  $\sigma_{\text{тек}}(H)$  имеет необычный вид (рис. 2) — при уменьшении  $\sigma_{\text{тек}}$  имеет место рост микротвердости.

Из литературы известно, что для разных материалов наблюдается отклонение от формулы Табора (1) [3–5,10]. Однако в основном оно сводится к тому, что константа  $C$  принимает различные значения, часто заметно отличающиеся от трех. Кристаллы  $\text{NaCl}: \text{Mn}$  являются первым примером, свидетельствующим, что  $\sigma_{\text{тек}}$  и  $H$  под влиянием одних и тех же факторов могут изменяться в противоположных направлениях.

\* Микротвердость измерялась с помощью прибора ПМТ-3 на плоскости скола (001) при нагрузке на индентор 10 г. Предел текучести определялся из опытов по одноосному сжатию вдоль оси [001] на машине Instron, скорость деформации  $1.5 \times 10^{-4} \text{ с}^{-1}$ . Эксперименты проводились при комнатной температуре.

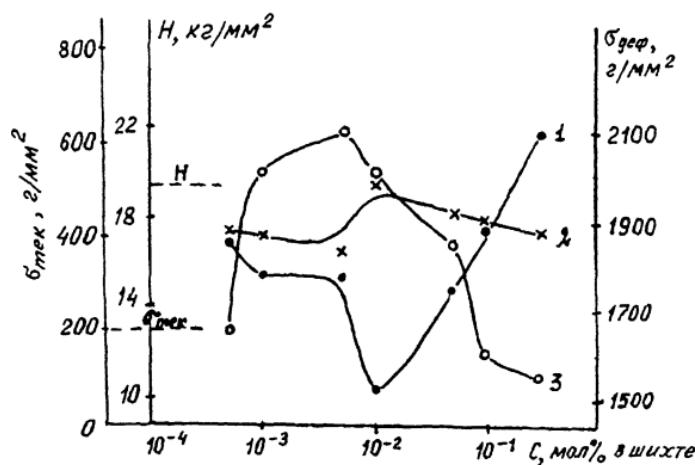


Рис. 1. Концентрационные зависимости предела текучести (1), микротвердости (2) и деформирующего напряжения  $\sigma_{\text{деф}}$  при  $\varepsilon = 8.5\%$  (3) для кристаллов NaCl:Mn. Штриховые линии указывают значения  $\sigma_{\text{тек}}$  и  $H$  для нелегированных кристаллов.

Одной из причин этого может явиться тот факт, что вдавливание индентора при измерении микротвердости производится в деформационно-упрочненный материал. В области отпечатка достигается пластическая деформация  $\varepsilon \sim 10\%$  [11]. Поэтому целесообразно сравнить поведение микротвердости и деформирующего напряжения  $\sigma_{\text{деф}}$  при  $\varepsilon \sim 10\%$ . Из рис. 1 следует, что зависимость  $\sigma_{\text{деф}}(c)$ , как и зависимость  $H(c)$ , характеризуется кривой с максимумом (кривая 3, рис. 1), т. е. действительно имеется лучшее соответствие между поведением  $H$  и  $\sigma_{\text{деф}}$ , чем  $H$  и  $\sigma_{\text{тек}}$ .

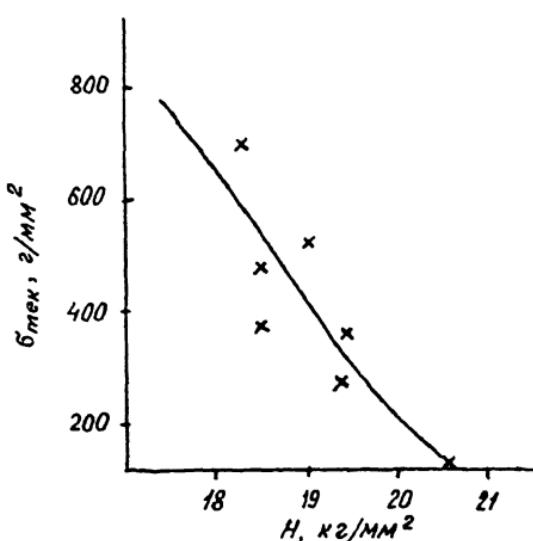


Рис. 2. Зависимость предела текучести от микротвердости для кристаллов NaCl:Mn.

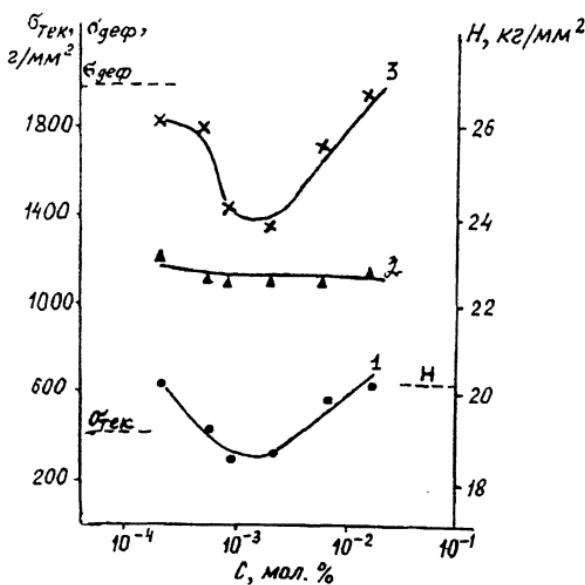


Рис. 3. Концентрационные зависимости предела текучести (1), микротвердости (2) и деформирующего напряжения при  $\epsilon = 10\%$  (3) для кристаллов  $\text{NaCl}:\text{Pb}$ .

Можно предположить, что наблюдаемые во многих материалах согласованные изменения микротвердости и предела текучести имеют место тогда, когда поведение  $\sigma_{тек}$  коррелирует с поведением  $\sigma_{деф}$ . В том же случае, когда такой корреляции нет, изменения микротвердости согласуются с изменениями деформирующего напряжения, а не предела текучести.

Однако эксперименты, проведенные на  $\text{NaCl}:\text{Pb}$ , показывают, что это предположение не оправдывается (рис. 3). Из рис. 3 следует, что для кристаллов  $\text{NaCl}:\text{Pb}$  изменение предела текучести при повышении концентрации примеси (кривая 1) хорошо согласуется с изменением деформирующего напряжения (кривая 3), поведение же микротвердости (кривая 2) не коррелирует ни с поведением  $\sigma_{тек}$ , ни с изменением  $\sigma_{деф}$ \*. Наличие таких ситуаций связано, по-видимому, со спецификой напряженного состояния при микроиндицировании, которое резко отличается от напряженного состояния при одноосном сжатии. При действии сосредоточенной нагрузки обычно оказываются активными все возможные системы скольжения, происходят взаимодействия дислокаций этих систем, в области около отпечатков индентора возникает высокая плотность дефектов и т. п. Для одноосной же деформации специфична другая картина деформирования. Однако в ряде случаев параметры пластической

\* Причина появления необычной концентрационной зависимости  $\sigma_{тек}(c)$  для кристаллов  $\text{NaCl}:\text{Pb}$  обсуждена ранее в [12].

деформации, характерные для обоих видов напряженного состояния ( $\sigma_{\text{тек}}$ ,  $\sigma_{\text{деф}}$ ,  $H$ ), могут определяться одними и теми же основными факторами, тогда между ними наблюдается хорошая корреляция. Например, для кристаллов NaCl:Ca таким фактором является подвижность дислокаций [5,10]. В этих кристаллах имеется хорошая корреляция между пределом текучести, подвижностью дислокаций в поле сосредоточенной нагрузки и микротвердостью. Для них изменения  $H$  пропорциональны изменениям  $\sigma_{\text{тек}}$ , т. е. выполняется зависимость, аналогичная формуле Табора (1).

Подводя итог изложенному, можно заключить следующее. Априори нельзя считать, что микротвердость и предел текучести меняются подобным образом под влиянием каких-либо факторов (например, при легировании). Их изменения могут различаться не только по величине, но и качественно (при увеличении одного параметра под воздействием каких-либо факторов происходит уменьшение другого). Наличие той или иной ситуации зависит от свойств исследуемого материала и специфики факторов, влияющих на изменения микротвердости и предела текучести.

### Список литературы

- [1] Tabor D. *The Hardness of Metals*. Oxford, Clarendon Press, 1953.
- [2] Tabor D. // *British Journ. Appl. Phys.* 1956. V. 7. C. 159–166.
- [3] Gerk A.P. // *Journ. Mat. Sci.* 1977. V. 12. C. 735–738.
- [4] Swain M.K., Lawn B.R. // *Phys. Stat. Sol.* 1969. V. 35. P. 909–924.
- [5] Боярская Ю.С., Грабко Д.З., Кац М.С. *Физика процессов микропрессирования*. Кишинев: Штиинца, 1986. с. 294.
- [6] Энциклопедия неорганических материалов. Киев, 1977. С. 500.
- [7] Sargent P.M., Donovan P.E. // *Scr. Metal.* 1982. V. 16. P. 1207–1212.
- [8] Chin G.L., Van Uitert L.G., Green M.L., Zydzik G. // *Scr. Met.* 1972. V. 6. P. 475–479.
- [9] Боярская Ю.С., Житару Р.П., Кац М.С. и др. // ФХОМ. 1981. № 6. С. 75–81.
- [10] Boyarskaya Yu.S., Zhitaru R.P., Linte M.A. // *Cryst. Res. Technol.* 1984. V. 19. P. 101–109.
- [11] Bacayuskas C.C. // Исследования в области измерения твердости. М.: Л.: Изд-во стандартов, 1967. С. 33–38.
- [12] Боярская Ю.С., Житару Р.П., Палистрант Н.А. // Письма в ЖТФ. 1993. Т. 19. С. 60–63.

Институт прикладной физики  
АН Молдовы  
Кишинев

Поступило в Редакцию  
12 июля 1995 г.